PRODUCTION OF MICROCHEMICAL DEVICE

Publication number: JP2000246092 (A)

Publication date: 2000-09-12

Inventor(s): ANAZAWA TAKANORI: TERAMAE ATSUSHI

Applicant(s): KAWAMURA INST CHEM RES

Classification:

- international: C12N15/09: B01J19/00: B01J19/12: C08F2/46: C12M1/00: G01N27/447:

G01N30/60; G01N37/00; G01N30/60; C12N15/09; B01J19/00; B01J19/12; C08F2/46; C12M1/00; G01N27/00; G01N30/00; G01N37/00; G01N30/00; G0

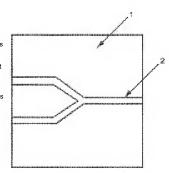
G01N30/60

- European:

Application number: JP19990056437 19990304 Priority number(s): JP19990056437 19990304

Abstract of JP 2000246092 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To bond members having a recessed part on the surface and another member to form an integrated body which are completely contacted with each other, without a minute space being closed by an adhesive in the production of a microchemical device, in which a space to be a passage and others is formed, by bonding/integrating the members, SOLUTION: A surface in which the recessed part of a member 1 is formed is contacted with a member 2 through a composition containing an energy ray curable compound. After a part excluding the recessed part formed in the member 1 is irradiated with energy rays to cure the composition, and the uncured composition in a space formed between the recessed part of the member 1 and the member 2 is removed



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

/E1\T_+ C17

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-246092 (P2000-246092A)

(43)公開日 平成12年9月12日(2000.9.12)

(51) Int.Cl.		藏別配号	F I	アーソコート(参考)				
B01J	19/12		B01J 1	19/12			E	4 B 0 2 4
	19/00	3 2 1	1	19/00		321		4B029
C08F	2/46		C08F	2/46				4G075
G 0 1 N	27/447		G01N 3	30/60			D	4 J O 1 1
	30/60		C 1 2 M	1/00			Α	
		審查請求	未請求 請求	真の数9	OL	(全 11	頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平11-56437	(71)出願人	0001737	751			
				財団法。	人川村	理化学研	究所	
(22)出願日		平成11年3月4日(1999.3.4)		千葉県	佐倉市	坂戸631都	計地	
			(72)発明者	穴澤 :	孝典			
				千葉県	菜県佐倉市大崎台4-35-4			
			(72)発明者	寺前 4	敦司			
				千葉県	佐倉市:	大崎台1	-28	3 − 1 − A −310
			(74)代理人	1000887	088764			
				弁理士	高橋	勝利		

T2 T

最終頁に続く

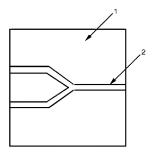
(54) 【発明の名称】 マイクロケミカルデバイスの製造方法

+0 pri+0 p.

(57)【要約】

【課題】 表面に凹部を有する部材と他の部材を接着一 体化させることにより、流路などとなる空間が形成され たマイクロケミカルデバイスを製造するに当たり、表面 に凹部を有する部材と他の部材とをの間を完全に密着さ せた状態で接着し、しかも接着剤が微小な空間を閉塞す ることなく接着一体化させる方法を提供すること。

【解決手段】 部材(A)の凹部が形成された面と部材 (B) をエネルギー線硬化性化合物を含有する組成物 (C)を介して接触させ、部材(A)に形成された凹部 を除く部分にエネルギー線を照射して組成物 (C)を硬 化させた後、部材(A)の凹部と部材(B)との間に形 成された空間中に存在する未硬化の組成物(C)を除去 することからなるマイクロケミカルデバイスの製造方



【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に深さ1~3000μmの凹部を有 する部材(A)と、他の部材(B)とを接着することに より部材(A)の凹部と部材(B)との間に形成された 空間を有するマイクロケミカルデバイスの製造方法であ って、

部材(A)の四部が形成された面と部材(B)をエネルギー線操化化合物を含有する組成物(C)を介して接助させ、部材(A)に形成された四部を除く部分にエネルギー線を理解して組成物(C)を硬化させた後、部材(A)の四部と部材(B)との間に形成された空間中に存在する未硬化の組成物(C)を除去することを特徴とするマイクロケミカルドバイスの製造方法。

【請求項2】 凹部が、幅1~3000μmの溝状である請求項1記載のマイクロケミカルデバイスの製造方法

【請求項3】 エネルギー総硬化性化合物が、アクリロ イル基又はマレイミド基を有するエネルギー線硬化性化 合物である請求項1記載のマイクロケミカルデバイスの 製造方法。

【請求項4】 表面に深き1~3000μmの凹部を有する部材(A)と、他の部材(B)を接着することにより部材(A)の凹部と部材(B)を接着することによるするでイクロケミカルデバイスの製造方法であって、部材(A)の凹部が形成された面と部材(B)をエネル接触させ、部材(A)に形成された面と部材(B)をイオル接触させ、部材(A)に形成された凹部を除、部分の一部にエネルギー線を照射して、組成物(C)を硬化させ、部材(A)の凹部と部材(B)との間に形成された空間中に存在する未硬化のエネルギー線硬化性組制物(C)を除去した後、凹部の間間の未硬化部分にエネルギー線を照射して硬化させることを特徴とするマイクロケミカルデバイスの製造方法。

【請求項5】 凹部が、幅1~3000μmの溝状である請求項4記載のマイクロケミカルデバイスの製造方法。

【請求項6】 エネルギー線硬化性化合物が、アクリロ イル基又はマレイミド基を有するエネルギー線硬化性化 合物である請求項4記載のマイクロケミカルデバイスの 製造方法。

【請求項7】 表面に深さ1~3000 μmの凹部を有 する部材(A)と、他の部材(B)を接着することによ り部材(A)の凹部に部材(B)とで形成され空間を 有するマイクロケミカルデバイスの製造方法であって、 部材(A)の凹部が形成された面と部材(B)をエネル 一般硬化化合物を含有する組成物(C)を介して検 触させた後、凹部の組成物(C)を除去した後、エネル ギー線を照射して、組成物(C)を映化させることを特 微とするマイクロケミカルデバスの製造方法 後とするマイクロケミカルデバスの製造方法

【請求項8】 凹部が、幅1~3000 µmの溝状であ

る請求項7記載のマイクロケミカルデバイスの製造方

【請求項9】 エネルギー線硬化性化合物が、アクリロ イル基又はマレイミド基を有するエネルギー線硬化性化 合物である請求項7記載のマイクロケミカルデバイスの 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の賦する技術が野1 4条明は、説小なケミカルデバイス、即ち、部材中に微小な流路、反応等、反応等、反応 電気は動かうな、クロマトカラム、服分部機構などの構造が形成された、化学、生化学、物理化学用などの成小 及応デバイス、化学、生化学、物理化学用などの成小 及応デバイス、微小電気法動デバイス、微小の心でト グラフィーデバイス、微小場を対策がバイス、微小の心で パイスなどの触小分析デバイスの製造方法に関し、更に 詳しくは、表面に清核その他の形状の川原を育する窓材 と他の部材をエネルギー総要化性倒落と加工に接着一体 化することにより形成された、キャビラリー状その他の 形状の空間を育する微小なケミカルデバイスの製造方法 に関する

[0002]

【健来の技術】シリコン、石英、ガラス、ボリマーなど の基板に、エッチング法などにより凹部を形成して、液 体道路や分隔甲がチャンネルとするマイクロケミカル デバイスが知られており(例えば、アール・エム・マコ ーミック等、「アナリティカル・ケミストリー」、第2 265 第 50 多、10 9 7 年)、長伸口次は大の 発防止、加圧による液体の輸送などを目的として、ガラ ス板などのカバーをネジ止めなどにより表面に密着させ で使用することが知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、基板と カバーとの間を完全に密着させることはかなり困難であ り、流路から差板とカバーとの間への液体の漏洩が生じ がちであった。

【0004】一方、これらの南部村を、接着物を用いて 接着すると、基板に形成された凹部とカバーとで形成さ れる空間に接続剤が入り込み、急空間を閉塞しがらであ り、微小な空間を形成することが困難であった。空間が 欄いキャビラリー状である場合には、その形成が単に困 種であった。

【0005】本発明が解決しようとする課題は、二つ以 上の部材の間に微小な空間を形成する方法であって、そ のような微小な空間を閉塞することなく、二つ以上の部 材を接着一体化させる方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記課題 を解決する方法について鋭意検討した結果、接着剤とし てエネルギー線硬化性化合物を含有するエネルギー線硬 化性組成物を使用し、表面に回席を有する都材と他の部 材を、エネルギー線硬化性組成物を挟んで接触させ、四 部を除く部かにエネルギー線照射して照射循环のエネル ギー線硬化性組成物を硬化をせた後、回部と他の部材と を除去する方法により、あるいは、表面に回路を有する 部材とこれに提音する他の部材をエネルギー線硬化組成物 を除去する方法により、あるいは、表面に回路を有する 部材とこれに提音する他の部材をエネルギー線硬化 成物を挟持して経験させた状態で、該回部の外の部分の 一部にエネルギー線を照射するか、又は照射せずに、該 回路と他の部材とで形成された空間中のエネルギー線硬 に性組成物を終ました後、エルギー線を照射して硬化 させる方法により、回部と他の部材とで形成された酸小 水空間を探索することなく接着できること、を見出し、 本発明を完成するに至った。

【0007】即ち、本発明は上記課題を解決するため に、(1) 表面に深さ1~3000μmの四部を有する 移材(A)と、他の部材(B)とを接書することにより 部材(A)の四部と部材(B)との間に形成された空間 を有するマイクロケミカルデバイスの製造方法であって、 部材(A)の四部が形成された面と溶材(B)を 大部分を指数である。 本ルギー線を照射して組成物(C)を辨比させた後、 部材(A)の四部と部材(B)との間に形成された空間 中に存在する未硬化の組成物(C)を除去することから なるマイクロケミカルデバイスの製造方法(以下、本発明の第1の製造方法(以下、本発明の第1の関系)という。を提供する。 を提供する。 を提供する を提供を を提供する を提供する を提供を を提供する を提供する を提供を

(10008) また、未売明れま」と記帳する。 は、(II) 表面に深さ 1~3000 μm 夕間節を 有する はが (A) ん。他の部材 (B) を接着することにより部 材 (A) の凹部と部材 (B) を接着することにより部 なマイクロケミカルデバイスの製造方法であって、部材 るマイクロケミカルデバイスの製造方法であって、部材 (A) の凹部が形成された面と部材 (B) をエネルギー 線硬化性(合物を含する部成物 (C) を使んして接触さ せ、部材 (A) に形成された四部を除く部分の一部に メルギー級を原則して、組成制 (C) を硬化させ、部材 (A) の凹部と部材 (B) との間に形成された空間中に 存在する未硬化のエネルギー線更化性相成物 (C) を ました後、凹部の周囲の未更に添かにエネルギー線を照 射して硬化させることからなるマイクロケミカルデバイ スの製造方法 (以下、本売明の第2の製造方法とい 。) を提供する。

【0009】さらに、木利明は上記課題を解決するため に、(III) 表面に深さ1~3000μmの四部を有す る部材(A)と、他の部材(B)を接着することにより 部材(A)の四部と部材(B)とで形成された空間を有 するマイクロケミカルデバイスの製造方法であって、部 材(A)の四部が形成された面と部材(B)をエネルギー ・減硬化性化合物を含有する組成物(C)を介して終始 させた後、四部の組成物(C)を除去たた後、エネルギ ー線を照射して、組成物 (C) を硬化させることからなるマイクロケミカルデバイスの製造方法(以下、本発明の第2の製造方法という。)を提供する。

[0010]

【発明の実施の無態】本売明の製造方法で用いるたる部材(A)は、本売明で得られるマイクロケミカルデバイスに使用する流体に対して不透過性であって、表面に、流かっまカルデバイスの空間となる回想を有するものである。 門部は、それ自体が部材(A)の端、即ら作業されるマイクロケミカルデバイス外へ連続していなくても良い、四部の深さは1 xm以上であり、5 xm以上がままし、10 xm以上であることがさらに対ましい。これより浅い四部を有するマイクロケミカルデバイスは製造が相談となる。 門部の深をは3000 xm以下である。500 m以下である。とがきらに対すました。これより浅い回部を有するマイクロケミカルデバイスは製造が相談となる。 門部の深をは3000 xm以下である。500 m以下が新まし、100 xm以下であることがきらに背ましい。これより淡いと本発明の效果が減どる

【0011】部材(A)の門端の平面形状は伝意であるが、最も狭い部分の幅(あるいは直径)が1 μm以上であることが対ましく、5 μm以上がさらた好ましく、1 0 μm以上であることがさらに好ましい。これより狭いと、製造が圧墜となる。凹部の最も狭い部分の幅(あるいは直径)は3000 μm以下であることが好ましく、500 μm以下が射ましく、100 μm以下であることが対ましく。100 μm以下であることが対ました。100 μm以下であることが対さした。一般である。100 km以がが対象状が減しる。一切部の平面形状が清状である場合に、特に本発明の効果が減じる。凹部の平面形状が清状である場合に、特に本発明の効果が残害できる。清の幅については、凹部の最も状態が分析についての法と同様である。また、凹部(清を含む)の傾向形状も、方形、台形、半円形など低寒である。また、凹部(清を含む)の傾向形状も、方形、台形、半円形など低寒である。

【0012】部材(A)の表面あるいは内部に、凹部に 接続して他の精造 例えば、部材外部との接続口、反応 構、流速計測部、弁、バルブ、ゲルが充填された溝、分 産販、などが形成されていても良い。

【0013】部材(A)の形程は特に限定する必要はなく、用途目的に応じた形状を採りうる。例えば、シート状(フィルム、リボンを含む)、板状、整膜は、棒状、チューブ状、その他複雑な形状の成型物などであり得るが、成形し場く、エネルギー総を照射し易いといった面から、接着すべき面が平面状の形状であること、特にシート状ズは抜枝であることが芽ましい。部材(A)は支持体の素材は任意であり、例えば、ボリマー、ガラス、セラミック、金属、半導体などであって良い。支持体の脱れ低性意であり、例えば、ボリマー、ガラス、セラミック、金属、半導体などであって良い。支持体の腹、棒状物、ボ、布、不満布、多孔質体、射出成型品等であって良い。複数のマイクロケミカルデバイスを1つの部材(A)と比較成することも可能であるし、製造

後、これらを切断して複数のマイクロケミカルデバイス とすることも可能である。

【0014】 部材(A)の業材は、本売明で使用するエネルギー線硬化性化合物を含有する組成物(C)で接着可能なものであれば特に期待はないが、検渉の部材(B)が未発明で使用するエネルギー線を適適させないのである場合には、未発明で使用するエネルギー線を透過させるものである必要がある。部材(A)の業材として使用可能なものでとして、例えば、ボリマー、ガラス、石英の両等結晶、セラミック、シリコンの血管半導体、金銭などが挙げられるが、これらの中でも、易成形性、高生産性、低価格などの点からボリマーが得に好ましい。

【0015】部材(A)に使用できるボリマーとして は、例えば、ポリスチレン、ポリーαーメチルスチレ ン、ポリスチレン/マレイン酸共重合体、ポリスチレン /アクリロニトリル共重合体の如きスチレン系ポリマ - ; ボルスルホン、ボリエーテルスルホンの如きポリス ルホン系ポリマー:ポリメチルメタクリレート、ポリア クリロニトリルの如き (メタ) アクリル系ポリマー:ポ リマレイミド系ポリマー:ビスフェノール A 系ポリカー ボネート、ビスフェノールF系ポリカーボネート、ビス フェノールZ系ポリカーボネートの如きポリカーボネー ト系ポリマー;ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリー 4-メチルペンテン-1の加きポリオレフィン系ポリマ - : 塩化ビニル、塩化ビニリデンの如き塩素含有ポリマ 一:酢酸セルロース、メチルセルロースの如きセルロー ス系ポリマー;ポリウレタン系ポリマー;ポリアミド系 ポリマー:ポリイミド系ポリマー;ポリー2,6-ジメ **チルフェニレンオキサイド、ポリフェニレンサルファイ** ドの如きポリエーテル系又はポリチオエーテル系ポリマ - ; ポリエーテルエーテルケトンの如きポリエーテルケ トン系ポリマー:ポリエチレンテレフタレート、ポリア リレートの如きポリエステル系ポリマー:エポキシ樹 脂;ウレア樹脂;フェノール樹脂等を挙げられる。これ らの中でも、接着性が良好な点などから、スチレン系ポ リマー、(メタ)アクリル系ポリマー、ポリカーボネー ト系ポリマー、ポリスルホン系ポリマー、ポリエステル 系ポリマーが好ましい.

【0016】部材(A)に使用するボリマーは、単独重合体であっても、共重合体であっても良く、また、熱可能性ボリマーであっても良い。生産性の面から、部材(A)に使用するボリマーは、熱可塑性ボリマー又はエネルギー線硬性性の架構造合体であることが好ましい。また、部材(A)は、ボリマーブレンドやボリマーフロイで構成されていても良いし、積層体その他の接合体であっても良い。さらに、部材(A)は、改質剤、着色剤、充填材、強化材などの添加物を含を力とも良い。

【0017】部材(A)に含有させることができる改質

利としては、例えば、シリコンオイルやフッ素置換炭化 水素などの疎木化剤 (搾水剤):水溶性ポリマー、界面 活性剤、シリカゲルなどの無機粉末、などの親水化剤が 挙げられる。

【0018】部材(A)に含有させることができる着色 剤としては、任意の染料や顔料、蛍光性の染料や顔料、 紫外線吸収剤が挙げられる。

【0019】部材(A)に含有させることができる強化 材としては、例えば、クレイなどの無機粉末、有機や無 機の繊維が挙げられる。

【0020】部材(A)が接着性の低い素材、例えば、ボリオレフィン、フッ素系ポリマー、ボリフェニンサルファイド、ボリエーテルエーテルケトン等の場合には、部材(A)の接着面の表面処理やアライマーの使用により、接着性を向上させることが変えいい。

【0021】また、本海明のマイクロケミカルデバイス の使用に当たって、接着性を向上させる目的や、タンパ 夕質などの落置のデバイス表面に小の残者を到前する目的 で、部材(A)の溝の表面を観水化することも好まし い。 観水化処理は溝の表面に限定されず、その他の部分 も処理されてよい。

【〇〇22】本売明で使用する部材(B)は、使用する 流体に対して不適適性であって、部材(A)の消息が減ら たれた価に接着し、部材(A)の凹部と部材(B)でも って空間を形成可能なものであれば、その形状、素材、 精造、表面状態などは任意である。これらについては、 その表面に凹部が形成されているを要が無いこと以外 は、部材(A)の場合と同様である。部材(B)は表面 に凹部が形成されている必要が無いこと以外 の構造が形成されている必要がが、凹部や凹部以外 の構造が形成されている必要ながが、凹部や凹部以外 の構造が形成されている必要ながが、凹部や凹部以外 の構造が形成されている必要ながが、凹部や凹部以外

の情報が形成されていても良い。前的(日)は、前的(日)は、前的(日)は、前的(日)が本発明で使用するエネルギー線を透過させないものである場合には、本発明で使用するエネルギー線を透過させるものである必要がある。

【0023】本売明に使用するエネルギー藤硬化性化合物は、硬化して部代(A)と部代(B)を挟奪できるものであれば、ラジカル重合性、アニオン重合性、カチオン重合性等任意のものであってよい。エネルギー線硬化性化合物は、重合問始剤の存在下ででのみエネルギー線により重合するものも使用することができる。

【0024】そのようなエネルギー線硬化性化会物としては、重合性の炭素一炭素工業結合を有する物が好ましく、中でも、反応性の高い (メタ) アクリル系化合物やビニルエーテル類、また光重合開始剤の不存在下でも硬化するマレイミド系化合物がませい。エネルギー線硬化性化合物としては、十分に硬化し接着可能なものであれば、単官能のモノマー及び/又はオリゴマーであっても良いが、高い接着焼皮を得るためには架橋重合性化合物、例えば、多官能のモノマー及び/又はオリゴマーであることが軽さしい。

【0025】エネルギー線硬化性化合物として使用でき る (メタ) アクリル系モノマーとしては、例えば、ジエ チレングリコールジ (メタ) アクリレート、ネオペンチ ルグリコールジ (メタ) アクリレート、1、6-ヘキサ ンジオールジ (メタ) アクリレート、2、2'ービス (4-(メタ)アクリロイルオキシポリエチレンオキシ フェニル) プロバン、2,2'ービス(4-(メタ)ア クリロイルオキシポリプロビレンオキシフェニル) プロ パン、ヒドロキシジピバリン酸ネオペンチルグリコール ジ (メタ) アクリレート、ジシクロペンタニルジアクリ レート、ビス (アクロキシエチル) ヒドロキシエチルイ ソシアヌレート、N-メチレンビスアクリルアミドの如 き2官能モノマー;トリメチロールプロバントリ(メ タ) アクリレート、トリメチロールエタントリ (メタ) アクリレート、トリス (アクロキシエチル) イソシアヌ レート、カプロラクトン変性トリス(アクロキシエチ ル) イソシアヌレート、の如き3官能モノマー:ペンタ エリスリトールテトラ (メタ) アクリレートの如き 4官 能モノマー:ジベンタエリスリトールヘキサ(メタ)ア クリレートの如き6官能モノマー:2-イソシアネート エチルメタクリレートの加き他の契頼性官能基を有する 単官能モノマー、などが挙げられる。

【0026】また、エネルギー線硬化性化合物として、 重合性オリゴマー(プレポリマーとも呼ばれる)を用い ることもでき、例えば、重量平均分子量が500~50 000のものが挙げられる。そのような蛋合性オリゴマ しては、例えば、エボキン樹脂の (メタ) アクリル酸 エステル、ポリエーテル樹脂の (メタ) アクリル酸エステル、ポリアタジエン樹脂の (メタ) アクリルセステル、分子末端に (メタ) アクリロル基を有するポリウ レタン樹脂などが挙げられる。

【0027】マレイミド系のエネルギー線硬化性化合物 としては、例えば、4、4'-メチレンビス(N-フェ ニルマレイミド)、2、3-ビス(2、4、5-トリメ チルー3-チエニル) マレイミド、1,2-ビスマレイ ミドエタン、1,6-ビスマレイミドヘキサン、トリエ チレングリコールビスマレイミド、N, N'-m-フェ ニレンジマレイミド、m-トリレンジマレイミド、N. フェニルメタンジマレイミド、N, N'ージフェニルエ ーテルジマレイミド、N, N' -ジフェニルスルホンジ $\forall \nu 1 \in \mathbb{N}, 1, 4 - \mathbb{N}, (\forall \nu 1 \in \mathbb{N}, 1 \in \mathbb{N}) = 1,$ 4-ジアゾニアビシクロー[2,2,2]オクタンジク ロリド、4、4' -イソプロピリデンジフェニル=ジシ アナート·N. N' - (メチレンジ-p-フェニレン) ジマレイミドの如き2官能マレイミド: N-(9-アク リジニル) マレイミドの如きマレイミド基とマレイミド 基以外の重合性官能基とを有するマレイミド、などが挙 げられる。マレイミド系のモノマーは、ビニルモノマ 一、ビニルエーテル類、アクリル系モノマー等の重合性 炭素・炭素二重結合を有する化合物と共重合させること もできる。

タ) アクリル系モノマーとしては、例えば、メチルメタ クリレート、アルキル (メタ) アクリレート、イソボル ニル (メタ) アクリレート、アルコキシボリエチレング リコール (メタ) アクリレート、フェノキシジアルキル (メタ) アクリレート、フェノキシボリエチレングリコ ール(メタ)アクリレート、アルキルフェノキシボリエ チレングリコール (メタ) アクリレート、ノニルフェノ キシボリプロピレングリコール (メタ) アクリレート ヒドロキシアルキル (メタ) アクリレート、グリセロー ルアクリレートメタクリレート、ブタンジオールモノ (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシー3-フェノキ シプロピルアクリレート、 2-アクリロイルオキシエチ ルー2-ヒドロキシプロピルアクリレート。 エチレノキ サイド変性フタル酸アクリレート、w-カルゴキシアプ ロラクトンモノアクリレート、2-アクリロイルオキシ プロビルハイドロジェンフタレート、2-アクリロイル オキシエチルコハク酸、アクリル酸ダイマー、2-アク リロイスオキシプロピリヘキサヒドロハイドロジェンフ タレート、フッ素置換アルキル (メタ) アクリレート、 塩素置換アルキル (メタ) アクリレート、スルホン酸ソ ーダエトキシ (メタ) アクリレート、スルホン酸-2-メチルプロパン-2-アクリルアミド、燐酸エステル基 含有(メタ)アクリレート、スルホン酸エステル基含有 (メタ) アクリレート、シラン基含有(メタ) アクリレ ート、((ジ)アルキル)アミノ基含有(メタ)アクリ レート、4級((ジ)アルキル)アンモニウム基含有 (メタ) アクリレート、(N-アルキル) アクリルアミ ド、(N. N-ジアルキル) アクリルアミド、アクロロ イルモリホリン、などが挙げられる。

【0030】観度物(C) に混合使用できる順宜能でし えド系モノマーとしては、例えば、Nーメチルマレイ ミド、Nーエチルマレイミド、Nーブチルマレイミド、 Nードデシルマレイミドの効能 Nーアルキルマレイミド ド・Nーシロヘキシルマレイミドの効能 N・N・開環能マ レイミド・Nーペンジルマレイミド・Nーフェールマレイミド、Nープ アルコキシフェニルマレイミド、Nーグ アルコキシフェニルマレイミド、Nーグ アルコキシフェニルマレイミド、Nーグ ニル) マレイミド、2、3-ジクロロ-N-(2、6-ジエチルフェニル)マレイミド、2、3-ジクロローN (2-エチル-6-メチルフェニル)マレイミドの如 きN-(置換又は非置換フェニル)マレイミド:N-ベ ンジル-2、3-ジクロロマレイミド、N-(4'-フ ルオロフェニル)-2,3-ジクロロマレイミドの如き ハロゲンを有するマレイミド: ヒドロキシフェニルマレ イミドの如き水酸基を有するマレイミド: N-(4-カ ルボキシー3-ヒドロキシフェニル) マレイミドの如き カルボキシ基を有するマレイミド: N-メトキシフェニ ルマレイミドの如きアルコキシ基を有するマレイミド; N-[3-(ジェチルアミノ)プロピル]マレイミドの 如きアミノ基を有するマレイミド; N-(1-ピレニ ル)マレイミドの如き多環芳香族マレイミド; N-(ジ メチルアミノー4-メチル-3-クマリニル)マレイミ ド、N-(4-アニリノ-1-ナフチル)マレイミドの 如き複素環を有するマレイミド、などが挙げられる。

【○○31】組成物(C)の粘度の軽適な値え、形成する空間の大きさに依存し、空間が能小である場合はど低格度とすることが好ましい。例似ば、10ℓmオーダー以下の幅(あないは直径)の空間を形成する場合には対り、000mPa。 s以下であることが好ましい。そのために、上記門管能モノマーを混合することが好ましい。組成物(C)の粘度が過大であると、未硬化の該組成物(C)の粘度が過大であると、未硬化の該組成の除去に時間を要する側向にあるので、新生してない。【○○32】組成物(C)には、必要に応じて、光重合開始剤、溶剤、増粘剤、改質剤、着色剤、などのその他の成分を混合して使用することができる。

【0033】組成物(C)に必要に応じて使用すること ができる光重合開始割は、本発明で使用するエネルギー 線に対して活性であり、エネルギー線硬化性化合物を重 合させることが可能なものであれば、特に制限はなく、 例えば、ラジカル重合開始剤、アニオン重合開始剤、カ チオン重合開始剤であって良い。そのような光重合開始 削としては、例えば、p-tert-ブチルトリクロロアセ トフェノン、2,2'=ジエトキシアセトフェノン、2 ーヒドロキシー2-メチルー1-フェニルプロパン-1 オンの如きアセトフェノン類;ベンゾフェノン、4、 4'-ビスジメチルアミノベンゾフェノン、2-クロロ チオキサントン、2-メチルチオキサントン、2-エチ ルチオキサントン、2-イソプロピルチオキサントンの 如きケトン類:ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテ ル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソ ブチルエーテルの如きベンゾインエーテル類:ベンジル ジメチルケタール、ヒドロキシシクロヘキシルフェニル ケトンの加きベンジルケタール類: N-アジドスルフォ ニルフェニルマレイミドの加きアジドなどが挙げられ る。また、マレイミド系化合物の如き重合性光重合開始 剤を挙げることができる。

【0034】重合性光重合開始剤は、例えば、エネルギ

一線硬化性化合物として例示した多言能マレイミドの如き多盲能モノマーの他、組成物(C)に混合使用できる はではでレイミド系モノマーとして例示したような単官能モノマーであっても良い。

【0035】組成物(C)に光重合開始剤を混合使用する場合の使用量は、非重合性光重合開始剤の場合、0.05~20重量%の範囲が好ましく、0.01~2重量%の範囲が好ましく、0.01~2重量%の範囲が昇に好ましい。

【0036】組成物(C)に必要に応じて混合使用する ことができる増貼剤としては、例えば、エネルギー縁硬 化性化合物に可溶でゲルに不溶なリニアボリマーが挙げ られる。

【0037】組成物(C)に必要に応じて混合使用する ことができる改質剤としては、例えば、搾水剤として機 能するシリコンオイルやフッ素置換炎化水素などが挙げ られる。

【0038】組成物(C)に必要に応じて混合含有する ことができる着色剤としては、任意の染料や顔料、蛍光 色素が挙げられる。

【〇〇39】本売明の第1の製造方法は、部材(A)の 回路が形成された面と部材(B)を重度物(C)を介し て接触せた。第14 (A) に表現された四部を除。部分に エネルギー線を照射してエネルギー線硬化性化合物を硬 化させた後、部材(A) の四部と部材(B)との間に形 成された空間中で右右する未現化の組成物(C) を続 することによって、部材(A)と部材(B) とと接着さ せるとともに、2つの部材の間に空間を形成する方法で ある。

【〇〇4〇】部村(A)の開始が形成された面上部村 (B)とを組成物(C)を介して接触させる方法は任意 である。例之ば、部村(A)及び/又は部村(B)に組 成物(C)を途布して重ねる方法や、部村(A)又は部 村(B)上に組成物(C)を流いて重ねることにより、 組成物(C)を部付(A)と部村(B)の間に押し広げ る方法、両面に組成物(C)を途布したシート状部村を 部代(A)と部村(B)の間に近んで重ねる方法、など を採用することができる。

【 00 4 1 1 部材 (A) 及び/又は部材 (B) にエネル ギー線架化性信合物を塗布する場合には、該部材の上に 途布できる任意の塗布方法を用いることができ、例え ば、スピンコート法、ローラーコート法、深運法、ディ ッピング法、スプレー法、バーコーターを用いる方法、 、一Yアプリケータによる方法、スクリーン印刷法、凸 版印刷法、グラビア印刷法、などの方法を採用すること ができる。塗布部位は、任意であり、部材 (A) と部材 (B) とが接触する面全体であっても、部分的であって も良いが、接着後形成されるキャピラリーの周囲を囲む 部位であることが好ましい。この時、部材 (A) の四部 や、各部材が接触する面と炒へ面に塗布されてもかまない。塗布界から任意である。部分的に塗布されてもかまって。 例えば、部材(A)の凹部に対面する位置を避けて部材(B)に塗布する場合には、X-Yアプリケーターを用いる方法や各種印刷法などにより実施することができっ

【0042】部材(A)と部材(B)は、組成物(C)を挟持した状態で接触させる。組成物(C)が挟持される溶症は、部材(A)とが材(B)とが接触する面全体であっても、試接触面中の一部分であっても良いが、接着後に形成されるキャピラリーの周囲を用む部位であることが好ましい。部材(A)と部材(B)を組成物(C)を挟持した状態で接触させるにあたり、エネルギーの線が住化合物が部材(A)の凹部に入り込んでも良い、部材(A)と形材(B)との間に挟持される組成物(C)の厚みは任意であるが、接着後に部材(A)の凹部と部材(B)とで形成される空間の寸法を一定に100μm以下であることが質ましく、100μm以下であることが質ましく、100μm以下であることが質ましく、100μm以下であることが質ましく、100μm以下であることが質ましく、100μm以下であることが質ましく、100μm以下であることが質ましく、100μm以下であることが質はしている強能で接触させるにあたり、第3の部材(B)と現状的で表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述を表述されている。

【0043】組成物(C)を供持した部材(A)と部材(B)は、部材(A)及び/又は部材(B)の外部の (B)は、部材(A)及び/又は部材(B)の外部の (C)を硬化させる。硬化に用いるエネルギー線としては、エネルギー線で性化化合物を硬化させることが可能 なものであり、かつ、部材(A)及び/又は海では をものである。このようなエネルギー線としては、紫外線、可投光線、赤外線などの光線、エックス 級、ガンで線下の電散が解は、電子線、イオンビーム、 ベータ線、重粒子線等の粒十線が挙げられるが、取り扱い性や硬化速度の面から素外線及び可視光がすましく、 無外線が可能力を

た状態で接触させても良い。

【0044】回線以外の部分にエネルギー線を照射する 方は任意であり、例えば、回部をフォトマスキングして エネルギー線を照射する方法や、レーザー光線ビームな どを走壺する方法を採ることができる。フォトマスキン グ法の場合、部分的な複数回の照射に分けることも可能 である。

【0045】硬化速度を速め、硬化を完全に行なう目的 で、エネルギー線の照射後を脱無濃度等開気で行なうこ とが好ましい。低酸素濃度等開気としては、窒素気流 中、二酸化炭素気流中、アルゴン気流中、真空又は減圧 雰囲気が好ましい。

【0046】エネルギー製照射により組成物(C)を硬化させた後、部材(A)の凹部と部材(B)とで形成された空間中の未硬化の組成物(C)を、設定間の外部への間口部から除去する。該空間が部材(A)の端、即ちマイクロケミカルデバイス外に関口していていない場合には、部材(A)及び/又は部材(B)の、空間に連絡する位置に孔を守つなどの方法により、間口部を形成す

ることができる。間口額は空間の同常であることが得ま しい、未硬化の組成物(C)を除去する方法は任意であ り、例えば、吸引、流体による活料し出し、栓実物による洗浄、超 青波洗浄などが適用できる。押し出しに使用できる流体 は、気体、液体、起臨界流体などであり得る。押し出し に使用できる流体は、未便化の組成物(C)を溶解させ ないものであって良い、溶解洗浄は溶剤の流通。溶剤存 在下での娘とうや超音波観射が利用できる。上記の方法 を同時気行でで良いし、溶解で押し出すことで、 上記の方法で良いし、公園で見い 側方は、吸引と押し出し と同時に行って良いし、公園で押し出すことで、現引及び 又は気体による押し出しの後、溶剤による洗浄を行うこ とが着といい。

【0047】未硬化の組成物(C)を除去した後、再度 エネルギー線を照射して、組成物(C)の硬化部と未硬 化部の境界部の硬化を完全にすることも好ましい。

【0048】本原門の第2の制造方法は、部材(A)の 門部が形成された両と部材(B)をエネルギー線硬化性 化合物を含有する組成物(C)を介して積融させ、部材 (A)に形成された凹部を除く部分の一部にエネルギー 線を照射して、エネルギー線硬化性化合物を硬化させ、 部材(A)の凹部と部材(B)との間に形成された登間 中に存在する未硬化の組成物(C)と除去した後、四部 の間間の未硬化部がにエネルギー線を開始して便におせ ることによって、部材(A)と部材(B)とを接着させ るととした、20の部材の間に空間を形成する方法であ ると。

【0049】即ち、本売明の第2の製造方法は、密材 (A)と部材(B)をまず部分的に接着して各部材の相 互位置を固定し、部材(A)の凹部と部材(B)との間 に形成された空間に存在する未硬化の組成物(C)を除 去した後、部材(A)の凹部以外の表面と部材(B)と の間に挟持された未硬化部分にエネルギー総を照射して 硬化させる方法である。

【0050】部材(A)と部材(B)との間に狭持される組成物(C)の厚みは、薄いことが好ましい。この厚みと門部の深さに比べて十分に得くすることで、渋持された組成物(C)を残し、部材(A)の凹部と部材(B)との間に形成された空間中に存在する組成物

(C) のみを選択的に除去することができる。狭特され る組成物(C) の厚みは100μm以下であることが野 ましく、10μm以下であることが更に好ましい。この 厚みがこれよりも厚いと、部材(A)の問題と部材 (B) との間に形成された空間中に存在する未硬化の組

(B) との間に形成された空間中に存在する未硬化の組成物(C) を除去する際に、該空間以外の部分の未硬化の組成物(C) も除去されがちとなるので、好ましくない。

【0051】部材(A)に形成された凹部を除く部分の 一部に対するエネルギー線照射は、部材(A)と部材 (B)を部分的に接着して各部材の相互位置を固定することにある。従って、この目的を達成できるものであれば、照射部位、形状、面積などは任意であり、例えば、スポットであり得る。

【0052】組成物(C)の除去方法は、本発明の第1 の製造方法に同様の方法が使用できるが、例えば、洗浄 明備などを設備してきたとは、狭時される地成物 (C)を残し、部材(A)の凹部と部材(B)との間に 形成された空間中に存在する組成物(C)のみを選択的 に除去することができる。表等明備などの機能学科は、 用いる系での簡単な実験によって求めることができる。 【0053】未硬化の組成物(C)を除去した機の サギー線を明像は未硬化部分のの原樹である必要はな

【0054】これ以外について、例えば、部材(A)、 部材(B)、組成物(C)、エネルギー線、塗布方法、 などに関しては、本発明の第1の製造方法の場合と同様 である。

く、部材全体への照射であって良い。

【0055】本発明の第2の製造方法は、本発明の第1 の製造方法と比べて、エネルギー練製材のパターニング 精度が低くでも良いため、製造が容易となる利点があ る。

【〇〇56]本発明の第3の製造方法は、部材(A)の 凹部が形成された面と部材(B)を組成物(C)を除去し、 な機能させんが悪で、固部の組成物(C)を除去し、エ ネルギー線を照射して組成物(C)を硬化させることに よって、部材(A)と部材(B)とを接着させるととも に、2つの部材の側に空間を光数する方法である。

【0057] 助ち、本売明の第3の製造方法は、部村 (A)と部材(B)間に組成物(C)を介して接触さ せ、クランプなどで部村間の相互位置を固定した状態 で、部材(A)の凹部と部材(B)との間に形成された 変間に存在する組成物(C)を除去し、その後、部材 (A)の凹部以外の表面と部材(B)との間に狭持された未硬化の組成物(C)にエネルギー線を照射して硬化 させる方法である。

【0058】部材(A)と部材(B)との間に狭持される組成物(C)の厚みについては、本発明の第2の製造方法の場合と同様である。

【0059】また、組成物(C)の除去についても本発明の第2の製造方法と同様である。

【0060】組成物(C)を除去した後のエネルギー線の照射は、組成物(C)が存在する部分のみの照射である必要はなく、部材全体への照射であって良いこと以外は、本発明の第1の製造方法と同様である。

【0061】これ以外について、例えば、部材(A)、 部材(B)、組成物(C)、エネルギー線、塗布方法、 などに関しては、本発明の第1の製造方法の場合と同様 である。

【0062】本発明の第3の製造方法は、本発明の第1

の製造方法と比べて、エネルギー線照射がパターニング 照射の必要がなく、全面照射でよいため、製造が容易で あるという利点を有する。

[0063]

【実施例】以下、実施例及び比較例を用いて、本発明を 更に詳細に説明するが、本売明よこれらの実施例の範囲 に限定されるものではない。なお、以下の実施例におい て、「部」及び「%」は、特に断りがない限り、各々 「重量部」及び「重量%」を表わす。

【0064】<実施例1>

[部材(A)の作製]アクリル樹脂(旭化成工業株式会 計製の「デルペット670N」) 製の厚さ3mの平板の 表面上に、1,6-ヘキサンジオールジアクリレート (日本化薬株式会社製の「カヤラッドHDDA」) 10 ○部及び紫外線重合開始剤1−ヒドロキシシクロヘキシ ルフェニルケトン(チバガイギー社製の「イルガキュア -184 L) 0.02部からなる混合物を25 mmのバ ーコーターを用いて塗布し、次いで、図1に示した形状 の凹部(2)となる部分に照射される紫外線を遮断する フォトマスクを介して、ウシオ電機株式会社製のマルチ ライト200型露光装置用光源ユニットを用いて、窒素 雰囲気中で10mW/cm2 の紫外線を10秒間照射し た。紫外線照射後、エタノールにて未硬化物を洗浄除去 した後、アクリル樹脂板を2.5cm×2.5cmに切断し 図1に示した形状の幅25 um×深さ26 umの満 状の凹部(2)が形成された部材(A) [A-1]

(1)を作製した。
【0065】(部材(B)の作製)部材(A)で使用したと同じアクリル樹脂の平板を切断して、2.5cm×
2.5cm×3mmの板状の部材(B) [B-1]を得た。
【0066】(組成物(C)の誤製)グリセロールアクリレートメタクリレート(新中村化学株式会社製の「N Kエステル701A」)100部及び柴外埠銀合開始剤ーヒドロキシシクロへキシルフェニルケトン(チバガイギー社製「イルガキュアー 184」)0.02部からなる組成物(C) [C-1]を測製した。

【0067】 (接着) 部材 (A) [A-1] (1) の四 (2) が形成された面に、望素ガス雰囲気中にて、ピペットにで排放物 (C) [C-1] 約0.1 cm² を置き、その上に、部材 (B) [B-1] (3) を接触させ、の力で挟み、周囲い押し出された相成物 (C) [C-1]を呼ばていぬぐい取った。クランプで挟んだ時点から約30 時後から10 科間、シオ電機株式会社製のマルチライト 200型霧光装運用光調ユニットを用い、図1の四部(2) の部分をフォトマスキングして、10 m (公) に関係 (三) に関係 (三)

した空間の期口部(4)から常圧のエタノールを導入し つつ、他方の開口部(図示せず)から吸引することによ り、部材(A) [A-1] (1) の四部 (2) と部材 (B) [B-1] (3) との間に形成された空間に充境 されている未硬化の組成物(C) を排除する日時に、 エタノールにて該空間に残存している組成物(C)を洗 浄除去して、図2に示した形状のマイクロケミカルデバ イス [D-1] を得た。

[0069] 「湍池減験」得られたマイクロケミカルデ バイス [D − 1] の間口部 (4) からマラカイトグリー く 和光地転転式会社製」に著色した水を0.1 MP aの水圧で導入し、他方の間口部 (母示せず)を閉じた 状態で、1時間耐電する減敏を行った結果、キャビラリ 一部から解析 (A) [A − 1] (1) と部材 (B) [B − 1] (3) の間除への水の潮洩や、部材 (A) [A − 1] (1) と部材 (B) [B − 1] (3) の測離は認め られなかった。

【0070】 〔断面觀察〕マイクロケミカルデバイス [D-1] を液体窒素温度で破断し、接着部の組成物 (C) の硬化物の厚みを測定したところ、約7μmであ

【0071】<実締例2>

(マイクロケミカルデバイスの作製)実施例1において、①四部(2)の部分をフォトマスナングにて業外線を照射する方法に代えて、部材(A)の四限から中心に向かって3mが順に入った位置を中心にして、直径5mの4つの点の部分(図示せず)にのみ紫外線照射したこと、②紫外線照射後、ラランプをはずし、実施例1と同様にして部材(A)[A-1](1)の四部と部材(B)[B-1](3)との間に形成された空間に充填されている未硬化の組成材(C)を除去したこと、及び、③節除法後に積層された部材の全体に、窒素雰囲気で同じ発度の紫外線を20分間照射したこと、以外は、実施例1と間様にして、図2に示した形状のマイクロケミカルデバイス[D-2]を作製した。

【0072】 (漏洩試験) 実施例2で得たマイクロケミ カルデバイス [D-2] について、実施例1と同様の漏 洩試験を行なって評価したところ、実施例1と同様の結 里を得か、

【0073】 〔断面観察〕 実施例2で得たマイクロケミ カルデバイス [D-2] について、実施例1と同様の断 面観察を行なって評価したところ、実施例1と同様の結 単を得か、

【0074】<実施例3>

[マイクロケミカルデバイスの作製] 実施例1におい て、の集外構を照射する前に、クランアで固定した状態 で、実施例1と同様にして部材(A) [A-1](1) の凹部(2)と部材(B) [B-1](3)との間に形 成された空間に充填されている未硬化の組成物(C)形 飲ましたこと。及びの額除を接に、窒素雰囲気中で、3 kwメタルハライドランア2本を用いて、クランアで固定された部材の表裏両臘からそれぞれ60mw/cw の業外線を10秒間同時に照射したこと、以外は実施例1と同様にして、図2に示した形状のマイクロケミカルデバイス「D-31を作製した。

【0075】 〔漏洩試験〕実施例3で得たマイクロケミ カルデバイス [D-3] について、実施例1と同様の漏 減試験を行なって評価したところ、実施例1と同様の結 果を得た。

【0076】 「斯面觀察」実施例3で得たマイクロケミ カルデバイス [D-3] について、実施例1と同様の断 面観察を行なって評価したところ、実施例1と同様の結 果を得た。

【0077】<実施例4>

「マイクロケミカルデバイスの作製)実施例 1において、組成物(C)[C-1]に代えて、グリセロールアクリレート、第中村化学株式会社製の「NKエステル7の1A」)50部及びN-シクロへキシルマレイミド(東京化成株式会社製)50部からなる組成物(C)[C-4]を用いた以外は、実施例1と同様にして、図2に示した形状のマイクロケミカルデバイス「D-5]を便制した。

【0078】 〔漏洩試験〕実施例4で得たマイクロケミカルデバイス [D-4] について、実施例1と同様の漏洩試験を行なって評価したところ、実施例1と同様の結果を得か。

【0079】 (断面観察) 実施例4で得たマイクロケミ カルデバイス [D-4] について、実権例1と同様の断 面観察を行なって評価したところ、実施例1と同様の結 果を得た。

【0080】<実施例5>

【マイクロケミカルデバイスの作製〕実施例2において、組成物(C) [C−1]に代えて、実施例4で用いた組成物(C) [C−4]を用いた以外は、実施例2と開総にして、図2に示した形状のマイクロケミカルデバイス[D−5]を作製した。

【0081】 (漏洩試験) 実施例5で得たマイクロケミ カルデバイス [D-5] について、実施列1と同様の漏 視試験を行なって評価したところ、実施列1と同様の結 集を得た。

【0082】 [時面觀察] 実施例5で得たマイクロケミ カルデバイス [D-5] について、実施例1と同様の断 面觀察を行なって評価したところ、実施例1と同様の結 果を得た。

【0083】<実施例6>

【マイクロケミカルデバイスの作製〕実験例3において、親成物(C) [C−1]に代えて、実施例4で用いた組成物(C) [C−4]を用いた以内は、実施例3と同様にして、図2に示した形状のマイクロケミカルデバイス[D−6]を作製した。

【0084】 (漏洩試験) 実施例6で得たマイクロケミ カルデバイス [D-6] について、実施例1と同様の漏 視試験を行なって評価したところ、実施例1と同様の結 果を得た。

【0085】〔斯面觀察〕実施例6で得たマイクロケミ カルデバイス [D-6] について、実施例1と同様の断 面觀察を行なって評価したところ、実施例1と同様の結 果を得た。

【0086】<実施例7>

「マイクロケミカルデバイスの作製」実施例しておい て、部材(B)の素材として、アクリル樹脂に代えて、 ポリスチレン(大日本イン本化学工業株式会社製の「デ ィックスチレン XC-520」)を使用した以外は、 実施例しと同様にして、図乙に示した形状のマイクロケ ミカルデバイス [D-7]。本作製した。

【0087】 (漏池試験) 実施例7で得たマイクロケミ カルデバイス [D-7] について、実施例1と同様の漏 洩試験を行なって評価したところ、実施例1と同様の結 果を得た。

【0088】〔断面観察〕実施例7で得たマイクロケミ カルデバイス [D-7] について、実施例1と同様の断 面観察を行なって評価したところ、実施例1と同様の結 果を得た。

[0089]

【発明の効果】 未発明の製造方法によれば、四部が形成された部材と他の部材との間を完全に密着させることが 可能なため、興部材間に印象を入れた空間から日部材間へ の液体の漏池が生じないマイクロケミカルデバイスを製 造することができる。また、未発明の製造方法におして、 (、四部が形成された部材と他の部材との間に形成され た空間が接着剤で閉塞されること無く、部材間に微小 な、あるいは細い空間を有するマイクロケミカルデバイ スを製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例で使用した部材(A)を表面に直角な方向から見た平面図である。

【符号の説明】

1 部材(A) 2 凹部

【図2】実施例で作製したマイクロケミカルデバイスの 俯瞰図である。

【符号の説明】

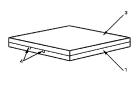
1 部材(A)

C 1 2 N 15/00

3 部材(B) 4 空間の開口部

2

[1]



[図2]

フロントページの続き

FI デーフンード (参考) GO1N 27/26 315K 331E

Α

F ターム(参考) 4B024 AA11 AA19 AA20 CA01 HA11

4B029 AA23 BB20

4G075 AA39 CA32 CA33 EE03 EE12

FA05 FB02 FB04 FB06 FB11

FB12 FC13

4J011 QA08 QA12 QA13 QA15 QA17

QA19 QA22 QA23 QA39 QA45 QB04 QB15 QB16 QB20 QB24

SA01 SA21 SA31 SA51 SA64

UA01 UA03 UA04 UA06 VA05

WA06